

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/obudowa-cte-c750-full-tower-argb-14cmx3-tempered-glass-snow-p-115415.html>



Obudowa CTE C750 Full Tower ARGB 14cmx3 Tempered Glass - Snow

Cena brutto	899,99 zł
Cena netto	731,70 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	KOTTKOB07000001
Kod producenta	CA-1X6-00F6WN-01
Kod EAN	4713227537162
Producent	Thermaltake
Maksymalna wysokość chłodzenia CPU	190
Opcjonalne chłodzenie wodne	1 x 120 mm (dół)
Maksymalna ilość wentylatorów	14
Zainstalowane wentylatory	1 x 140 mm ARGB (tył)
Liczba zainstalowanych wentylatorów	3
Podświetlenie obudowy	ARGB
Panel boczny	Szkoło hartowane
Maksymalna długość karty graficznej	420
Gwarancja	36 mc.
Typ obudowy	Big Tower
Moc zasilacza	Brak
Format obudowy	E-ATX
Złącza na przednim panelu	1 x mikrofon
Miejsca montażowe 2,5" wewn.	12
Liczba miejsc montażowych (sumaryczna)	19
Miejsca montażowe 3,5" wewn.	7
Pozostałe parametry	Wsparcie wentylatorów Front: 3 x 120mm, 2 x 120mm, 1 x 120mm 3 x 140mm, 2 x 140mm, 1 x 140mm 2 x 200mm, 1 x 200mm Top: 2 x 120mm, 1 x 120mm 2 x 140mm, 1 x 140mm Right (M/B Side): 3 x 120mm, 2 x 120mm, 1 x 120mm 3 x 140mm, 2 x 140mm, 1 x 140mm Rear:

Wymiary	562,5 x 327 x 599,2 mm
Waga	16.7
Kolor (wyliczeniowy)	Biały

Opis produktu

Obudowa CTE C750 TG ARGB Snow Full Tower

CTE C750 TG ARGB Snow to specjalnie zaprojektowana obudowa typu full tower E-ATX z nowej serii CTE, zaprojektowana tak, aby zapewnić wysoki poziom wydajności cieplnej krytycznym komponentom. Jest wyposażony w trzy fabrycznie zainstalowane wentylatory 140 mm CT140 ARGB i może obsługiwać maksymalnie 420 mm radiatory AIO z przodu, po stronie płyty głównej i z tyłu obudowy.

Współczynnik kształtu CTE

Zaprojektowane przez Thermaltake

Współczynnik kształtu CTE zaprojektowany przez Thermaltake oznacza scentralizowaną efektywność cieplną i koncentruje się na zapewnieniu wysokiego poziomu wydajności cieplnej krytycznych komponentów. Konstrukcja wykorzystuje obrót płyty głównej o 90 stopni, zapewniając bardziej wydajne ścieżki przepływu powietrza.

Ponieważ procesor został przesunięty znacznie bliżej panelu przedniego, a karta graficzna bliżej panelu tylnego, zapewnione jest niezależne doprowadzenie zimnego powietrza w celu rozpraszania ciepła odpowiednio procesora i karty graficznej. To ogólne podejście umożliwiło firmie CTE zapewnienie lepszego i bardziej wydajnego przepływu powietrza wlotowego poprzez rozmieszczenie głównych komponentów i chłodzenie, a także optymalizację odprowadzania ciepła z systemu.

Przesuń krytyczne źródła ciepła (procesor i karty graficzne) bliżej chłodnego powietrza

Ponieważ procesor CTE C750 został przesunięty znacznie bliżej panelu przedniego, a karta graficzna bliżej panelu tylnego, zapewnione jest niezależne doprowadzenie zimnego powietrza w celu rozpraszania ciepła odpowiednio procesora i karty graficznej.

Aktywne chłodzenie dla bardziej wydajnego przepływu powietrza dolotowego

To ogólne podejście umożliwiło CTE C750 zapewnienie lepszego i bardziej wydajnego przepływu powietrza wlotowego poprzez rozmieszczenie głównych komponentów i chłodzenie, a także optymalizację odprowadzania ciepła z systemu.

Zapewniamy wydajność chłodzenia przekraczającą wszelkie wyobrażenia!

CTE C750 TG ARGB Snow to specjalnie zaprojektowana obudowa typu full tower E-ATX z nowej serii CTE, zaprojektowana tak, aby zapewnić wysoki poziom wydajności cieplnej krytycznym komponentom. Jest wyposażony w trzy fabrycznie zainstalowane wentylatory 140 mm CT140 ARGB i może obsługiwać do 420 mm radiatorów AIO z przodu, z tyłu i po stronie płyty głównej. Jego dwukomorowa konstrukcja pozwala użytkownikom zaprezentować kluczowe komponenty i zapewnić dużo miejsca na doskonałe rozwiązania chłodzące, z możliwością umieszczenia do 14 wentylatorów wewnątrz obudowy dzięki przednim, dolnym i tylnym wspornikom wentylatorów oraz górnej i bocznej stronie M/B otwór wentylacyjny. Posiada również wiele drobnych szczegółów, takich jak obrotowe gniazda PCI-E, wyjmowane filtry, wspornik pompy i zbiornika oraz paski na rzepy ułatwiające zarządzanie kablami. Niezależnie od tego, czy szukasz obudowy do niestandardowego chłodzenia cieczą, czy podwójnej konfiguracji AIO, CTE C750 TG ARGB Snow to wysokiej klasy obudowa prezentacyjna, która pozwala wyobrazić sobie coś nieszałobowego.

Maksymalne wsparcie grzejników - do grzejników 360 mm/420 mm w wielu lokalizacjach

Nasz CTE C750 TG ARGB Snow oferuje doskonałe wsparcie chłodzenia dla entuzjastów niestandardowego chłodzenia cieczą, istnieją różne lokalizacje wsparcia i wystarczająco dużo miejsca na aranżację własnych konfiguracji. W naszym CTE C750 można jednocześnie zamontować do 5 grzejników (trzy 360 mm i dwa 240 mm), zapewniając niesamowitą obsługę grzejników.

Aby zapewnić kompatybilność z AIO, z przodu, z tyłu i po stronie płyty głównej można zainstalować radiatory o średnicy do 420 mm/360 mm, co daje entuzjastom komputerów PC nieograniczone możliwości idealnej konfiguracji.

Zmieszczą się wszystkie Twoje wymarzone komponenty chłodzące!

Obudowa CTE C750 Full Tower ma ogromną pojemność instalacji wentylatorów i chłodziw: do czternastu wentylatorów 140 mm i chłodziw AIO 360 mm/420 mm w różnych miejscach. Co więcej, wyposażone wsporniki wentylatorów z przodu, u dołu i z tyłu zapewniają łatwy montaż wszystkich pożądanych elementów chłodzących.

Zadziw swój świat trzema fabrycznie zainstalowanymi wentylatorami 140 mm CT140 ARGB

Obudowa CTE C750 TG ARGB Snow Full Tower jest wyposażona w trzy wentylatory 140 mm ARGB PWM z przodu, u góry i z tyłu. Efektami świetlnymi LED można manipulować za pomocą oprogramowania obsługiwanego przez płytę główną. Użytkownicy mogą stworzyć niesamowity pokaz oświetlenia RGB, jednocześnie ciesząc się najwyższą wydajnością chłodzenia.

- Typ obudowy: Big Tower

- Format obudowy: E-ATX
- Panel boczny: Szkło hartowane
- Podświetlenie obudowy: ARGB
- Liczba miejsc montażowych (sumaryczna): 19
- Miejsca montażowe 2,5" wewn.: 12
- Miejsca montażowe 3,5" wewn.: 7
- Moc zasilacza: Brak
- Liczba zainstalowanych wentylatorów: 3
- Zainstalowane wentylatory: 1 x 140 mm ARGB (tył)
- Maksymalna ilość wentylatorów: 14
- Opcjonalne chłodzenie wodne: 1 x 120 mm (dół)
- Złącza na przednim panelu: 1 x mikrofon
- Maksymalna długość karty graficznej: 420
- Maksymalna wysokość chłodzenia CPU: 190
- Kolor (wyliczeniowy): Białe
- Wymiary: 562,5 x 327 x 599,2 mm
- Waga: 16.7
- Pozostałe parametry: Wsparcie wentylatorów Front: 3 x 120mm, 2 x 120mm, 1 x 120mm 3 x 140mm, 2 x 140mm, 1 x 140mm 2 x 200mm, 1 x 200mm Top: 2 x 120mm, 1 x 120mm 2 x 140mm, 1 x 140mm Right (M/B Side): 3 x 120mm, 2 x 120mm, 1 x 120mm 3 x 140mm, 2 x 140mm, 1 x 140mm Rear: 3 x 120mm, 2 x 120mm, 1 x 120mm 3 x 140mm, 2 x 140mm, 1 x 140mm 2 x 200mm, 1 x 200mm Bottom: 3 x 120mm, 2 x 120mm, 1 x 120mm 3 x 140mm, 2 x 140mm, 1 x 140mm Wielkość chłodnicy Front: 1 x 360mm, 1 x 240mm, 1 x 120mm 1 x 420mm(AIO only), 1 x 280mm, 1 x 140mm Top: 1 x 240mm, 1 x 120mm 1 x 140mm Right (M/B Side): 1 x 360mm, 1 x 240mm, 1 x 120mm 1 x 420mm(AIO only), 1 x 280mm, 1 x 140mm Rear: 1 x 360mm, 1 x 240mm, 1 x 120mm 1 x 420mm(AIO only), 1 x 280mm, 1 x 140mm Bottom: 1 x 360mm, 1 x 240mm, 1 x 120mm 1 x 280mm, 1 x 140mm
- Gwarancja: 36 mc.